

证券代码： 600601

证券简称： 方正科技

## 方正科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号： 2024-0702

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2024年7月12日-7月15日
地点（方式）	线下交流
参与单位（或人员）	瑞信致远私募基金、鼎萨投资、望正资产、天风证券、长盛基金、鹏华基金、华夏未来资本、恒悦资管、景顺长城基金、信达澳亚基金、恒生前海基金、招商证券
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：梁加庆
投资者关系活动主要内容介绍	<p>调研会议互动问答的主要内容如下：</p> <p>问：公司 PCB 业务的情况介绍？</p> <p>答：公司 PCB 业务核心主体为珠海方正科技多层电路板有限公司，经过 30 余年的业务发展，在高多层和高密度互联（HDI）领域具有核心竞争力，在通讯设备、消费电子、光模块、服务存储、汽</p>

车电子、数字能源和工控医疗的产品应用领域均有布局。通过卓越的品质与客户建立了长期良好的技术协同，提供包括 PCB 设计、制造、仿真和测试的一站式解决方案，专业服务全球中高端客户。2023 年公司 PCB 业务实现营业收入 30.22 亿元，净利润 1.78 亿元。

**问：公司的短期经营情况如何？上半年业绩情况如何？**

答：2024 年上半年，随着数据中心、人工智能等领域的快速发展，PCB 市场行情好于去年同期。公司一是前瞻性预判客户技术方向和产品要求，对国内工厂进行技术能力升级，高端产品产能大幅提升；二是通过关键技术的不断突破，为客户提供更好的 PCB 产品一站式解决方案；三是积极布局高增长领域，持续优化客户群和产品订单结构；四是推进精细化管理，全面降本增效。2024 年上半年，公司的主要经营指标得以稳步提升。

公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 12,700 万元至 17,200 万元，与上年同期相比，将增加 7,895 万元到 12,395 万元，同比增加 164.33%到 257.98%。

**问：能否进一步说明服务存储业务的情况？对于 AI 服务器，公司有何布局和进展情况？**

答：公司内部将服务存储分为两类，一是传统的服务器；二是基于云计算的应用环境下的 AI 服务器。公司已具备 AI 服务器核心客户高可靠性产品及超密高阶 HDI 的制作能力，为未来的市场需求做好准备。

**问：公司在交换机领域的布局情况如何？是否已经开始实现批量生产？**

答：交换机领域公司已具备 400G 和 800G 的技术和批量生产能力。

**问：今年公司业务增量最大的部分是什么？光模块业务今年发展状况如何？**

答：2024 年，公司光模块业务增长较快，公司已批量生产 10G-100G-200G-400G-800G 等光模块产品，同时，1.6T 连接器和光模块产品分别已完成打样并具备批量生产能力。

**问：公司产能扩产投资情况？**

答：公司现有在运营的工厂共 4 间，公司持续对现有工厂进行技改，提升技术水平。国内 F3 工厂的技改、MSAP 产线、F7 二期 HDI 的投资均已完成，高端 HDI 产能占比正在稳步提升。海外投资约 9.43 亿元建设方正科技（泰国）智造基地项目，通过保质量、抢工期、控成本，各项工作正在按计划有序推进。

**问：公司 HDI 产能情况如何？与同行业的竞争对手相比，公司在高端高阶 HDI 领域的竞争力如何？**

答：目前，公司的 HDI 规划产能合计为 46.5 万平方英尺/月，其中 F3 工厂的规划产能为 35 万平方英尺/月，F7 二期 HDI 的规划产能为 11.5 万平方英尺/月。在 HDI 领域，公司处于国内行业前列，具有一定的行业竞争力。

**问：公司目前的技术布局？**

答：公司在高多层板及 HDI 技术领域有丰富的技术沉淀，生产技术达到国内先进水平。公司与国内通讯行业领军企业建立长期深度合作，同步展开多个 5G 主板及天线板 PCB 的研发项目；成功开发出 FVS，将 PCB 损耗控制和布线密度提升到更高的水平；开发出 Z-向互联技术，实现了多 PCB 的堆叠互联，有助于超高厚径比和局部高密复杂设计的产品的制作；其他特色工艺如 Cavity、UHD、阶梯金手指、特殊散热、能源厚铜和高端光模块等皆已量产，助力客户在研发 N+1 和 N+2 代产品中带来设计、成本和制作周期的优势，不断

追求卓越水平。

**问：公司在境外的业务布局？**

答：境外业务主要是公司 PCB 产品的出口，地区包括北美、欧洲、日本、韩国及其他亚洲国家或地区，境外业务约占公司整体营收的三分之一。

公司正在积极开拓境外市场，有序推进投资建设方正科技（泰国）智造基地项目，以满足境外订单需求。

**问：公司其他非 PCB 业务如何处理，后续是否考虑并购？是否会进入其他领域？比如是否会进入封装基板行业？**

答：公司目前还有少量的历史遗留业务——融合通信，正在积极探索盘活方式；目前公司提供包括 PCB 设计、制造、仿真和测试的一站式解决方案，公司将进一步聚焦 PCB 主业，并结合经营战略需要，寻找与公司 PCB 业务在市场、品类、技术、产业链上下游等能够资源互补的标的，探求战略并购。

**问：公司的资金情况如何，对于今后的扩张计划公司的融资策略是什么？**

答：目前公司资产负债率较低，主要依靠自有资金和银行借款融资。公司将根据公司战略发展规划、外部经营环境、实际投资需求以及相关政策的变化制定公司中长期投融资规划。

**问：铜材料成本上升对公司是否有影响？**

答：公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐等，原物料供应的稳定性和价格走势影响公司生产的稳定性和盈利能力。近期受铜等大宗商品价格变化影响，部分材料价格有所上升，目前对公司经营影响可控。PCB 产品价格传导受产品结构和供需结构的影响，公司会积极与供应链和客户保持沟通，保证公司的良性经营。

附件（如有）	无
记录时间	2024年7月16日整理